

スプレーコーティング装置

基板断面、斜面への均一なレジスト塗布が可能 MEMS / マイクロマシン開発用装置

特徴

Feature

- ステージ及び気流を制御することにより、基板断面、斜面に切れ目なくレジスト塗布が可能
- 高剛性・高速ステージを搭載し、低粘度のレジストを立体基板の上に積層させることが可能。
- 実験・研究開発用に最適
- 加熱可能なヒータ内蔵真空チャックを標準装備
- 煩雑な手順、パラメータ設定をレシピ登録可能
簡単操作により生産性、再現性の向上
- すべての機能を制御、監視可能なタッチパネルを採用

用途

- ・ MEMSデバイス試作・開発・量産
- ・ 膜厚レジスト塗付
- ・ 半導体などの立体配線
- ・ レジスト埋め込み、平坦化

用途

- ・ フォトレジストのアッシング
- ・ シリコン有機膜のアッシング



本製品は、豊田工業大学 佐々木教授、熊谷准教授との共同開発品です。

用途に合わせてカスタマイズ可能です。

段差基板への斜め露光パターンニングに最適です

